

PALTEK

(証券コード:7587)

2019年12月期 第2四半期 決算説明資料

2019.8.6 (火)

© 2019 PALTEK Corporation. All rights reserved.

本資料取り扱い上の注意点

本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき判断したもので、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

なお、本資料においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。

また、実際の業績に影響を与えうるリスクや不確実な要素には、以下のようなものが含まれます。

- ① 国内エレクトロニクス業界の急激な景気変動や需要動向の変化
- ② 仕入先の代理店政策の見直しや再編等により取引関係の継続が困難となった場合
- ③ 不測の事態による当社グループの情報資産が流出した場合
- ④ 為替相場の急激な変動
- ⑤ 新規仕入先商品の立ち上がりの遅れが生じた場合
- ⑥ 顧客の日本国内での製品開発案件が更に海外へシフトし、当社グループの販売活動が及ばない地域へ移管された場合

- ① **2019年12月期 第2四半期
業績結果**
- ② **2019年12月期 業績予想**
- ③ **今後に向けた取り組み**

- ① **2019年12月期 第2四半期
業績結果**

(百万円)	2018年第2四半期		2019年第2四半期		増減	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
売上高	15,585	100.0%	14,794	100.0%	△790	△5.1%
売上総利益	1,931	12.4%	1,703	11.5%	△228	△11.8%
販管費	1,549	9.9%	1,641	11.1%	91	5.9%
営業利益	381	2.4%	61	0.4%	△319	△83.8%
経常利益	227	1.5%	62	0.4%	△165	△72.6%
親会社株主に帰属する四半期純利益	133	0.9%	23	0.2%	△110	△82.4%
1株当たり四半期純利益	12.21円	-	2.15円	-	△10.05円	△82.4%

主な増減要因

- 売上高の減少は、半導体事業の減少による
- 売上総利益の減少は、売上高が減少および売上総利益率の低下による
- 営業利益の減少は、売上総利益の減少および新規事業への投資などによる販管費の増加による

(百万円)	2018年第2四半期		2019年第2四半期		増減	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
半導体	14,681	94.2%	13,473	91.1%	△1,208	△8.2%
デザインサービス	814	5.2%	867	5.9%	53	6.6%
ソリューション	89	0.6%	453	3.0%	364	407.4%
売上高合計	15,585	100.0%	14,794	100.0%	△790	△5.1%

主な増減要因

- 半導体事業は、医療機器や計測機器向けなどにFPGAが増加した一方で、海外の携帯情報端末向けメモリ製品が大幅に減少したことなどを受け減少
- デザインサービス事業は、航空/宇宙分野、産業機器向けなどが増加
- ソリューション事業は、映像配信システムおよび産業向けIoTシステムの販売が増加

■ 売上総利益率の低下は、以下の2つが要因

- ドル円相場の変動により、仕入先に対して保有する仕入値引ドル建債権の評価額は変動
売上総利益に対する影響額は、
2018年第2四半期では△146百万円（△0.9%分）
2019年第2四半期では△186百万円（△1.3%分）

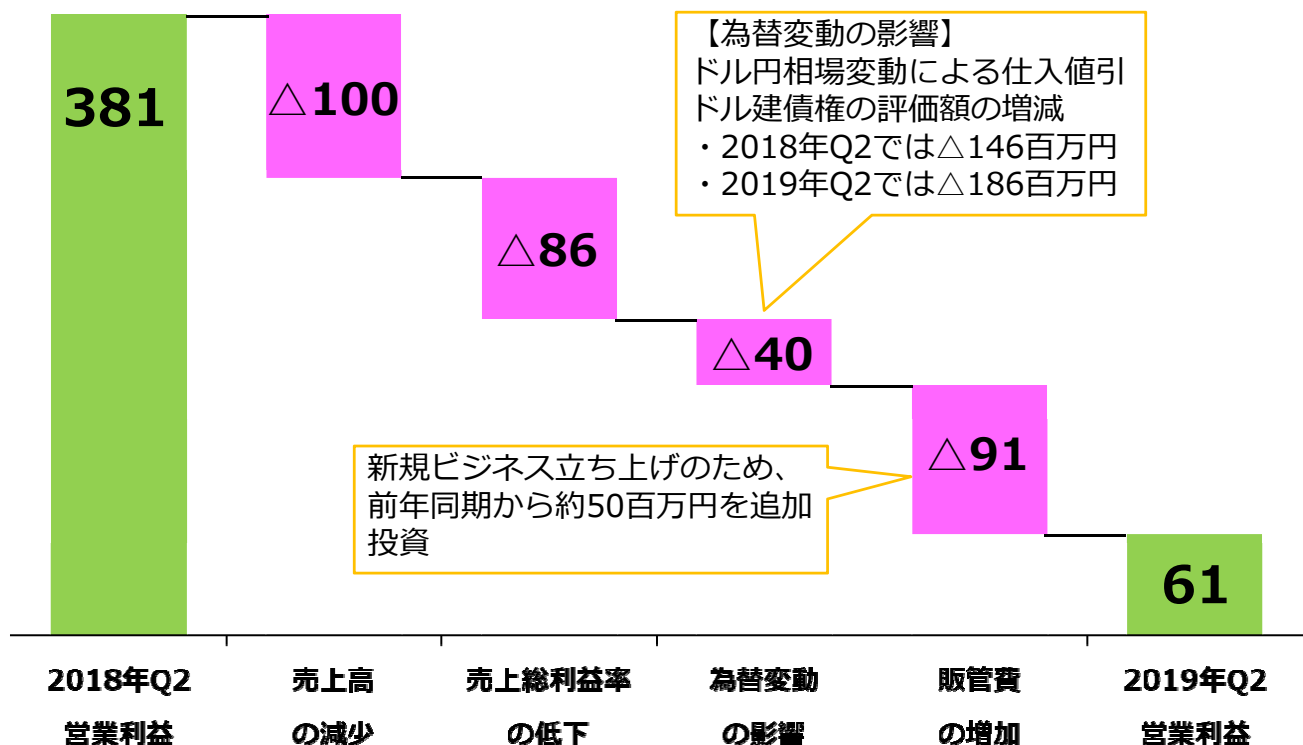
(百万円)	2018年第2四半期		2019年第2四半期	
	金額	対売上比率	金額	対売上比率
売上総利益	1,931	12.4%	1,703	11.5%
(うち為替の影響額)	△146	△0.9%	△186	△1.3%
売上総利益 (為替の影響を排除)	2,077	13.3%	1,889	12.8%

- 半導体事業において、FPGAビジネスで取引形態の変更により、主要大手顧客(一部)の利益率が低下

7

© 2019 PALTEK Corporation. All rights reserved.

(単位：百万円)



8

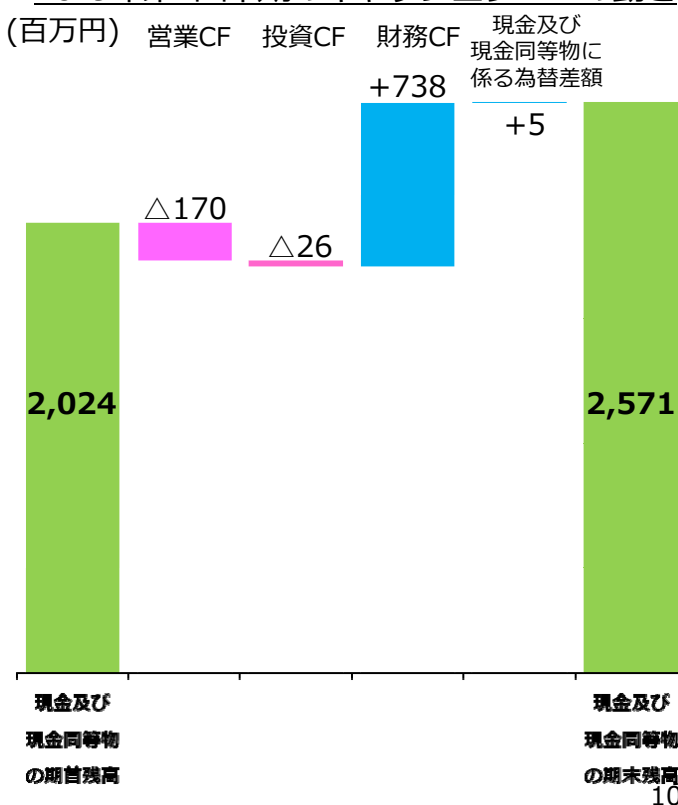
© 2019 PALTEK Corporation. All rights reserved.

連結貸借対照表の状況

	(百万円)	2018.12	2019.06	増減額	主な増減理由
資産内訳	現金及び預金	2,024	2,571	547	
	売上債権	6,354	6,802	447	
	商品	3,126	3,456	330	
	その他流動資産	1,844	1,620	△223	未収入金が減少
	固定資産	497	584	87	
資産合計		13,846	15,035	1,188	
負債純資産内訳	仕入債務	945	989	43	
	短期借入金	2,010	2,860	850	
	その他流動負債	1,091	1,501	410	
	固定負債	256	229	△27	
	純資産	9,542	9,455	△87	
負債・純資産合計		13,846	15,035	1,188	

連結キャッシュ・フローの状況

2019年第2四半期のキャッシュフローの動き



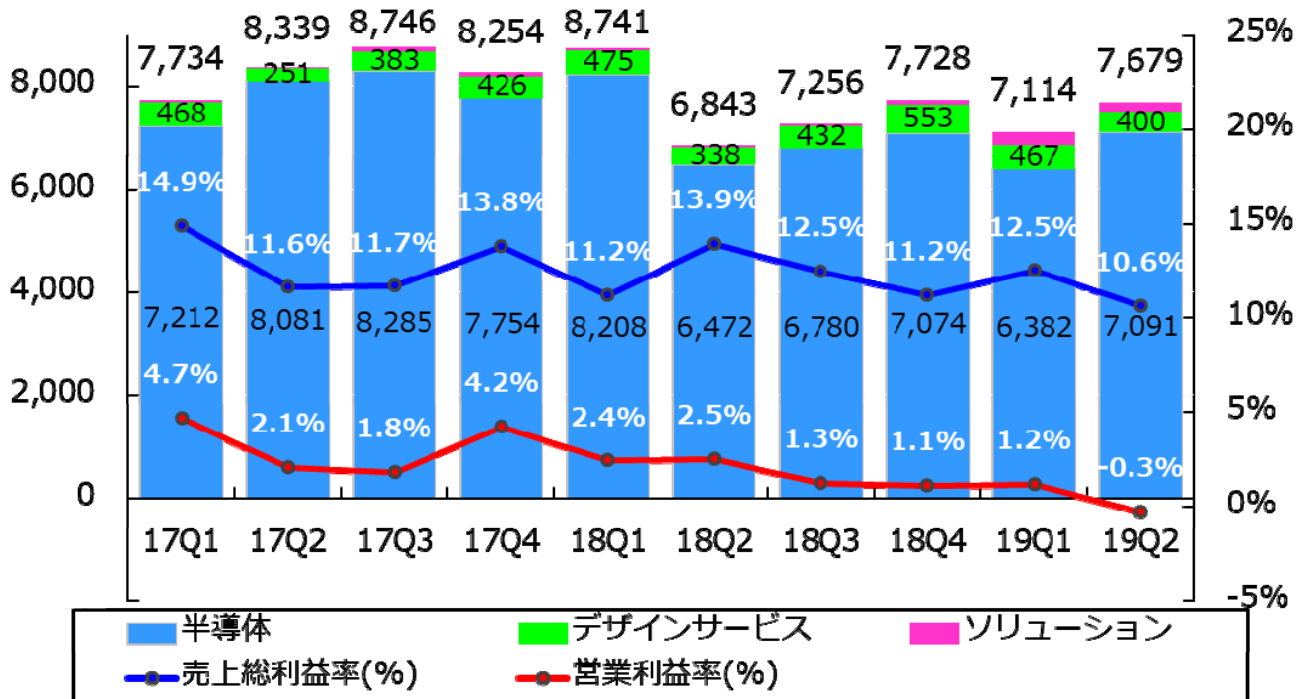
(百万円)	2018年第2四半期	2019年第2四半期
現金及び現金同等物の期首残高	2,178	2,024
営業CF	3,906	△170
投資CF	△60	△26
財務CF	△3,974	738
現金及び現金同等物の期末残高	2,041	2,571

2019年第2四半期キャッシュフローの動き

- 【営業CF】税金等調整前四半期純利益の計上および未収入金減少の一方で、売上債権、たな卸資産および未収消費税等の増加により支出
- 【投資CF】有形固定資産および無形固定資産の取得により支出
- 【財務CF】配当金支払いを実施した一方で、借入れ実施などにより収入

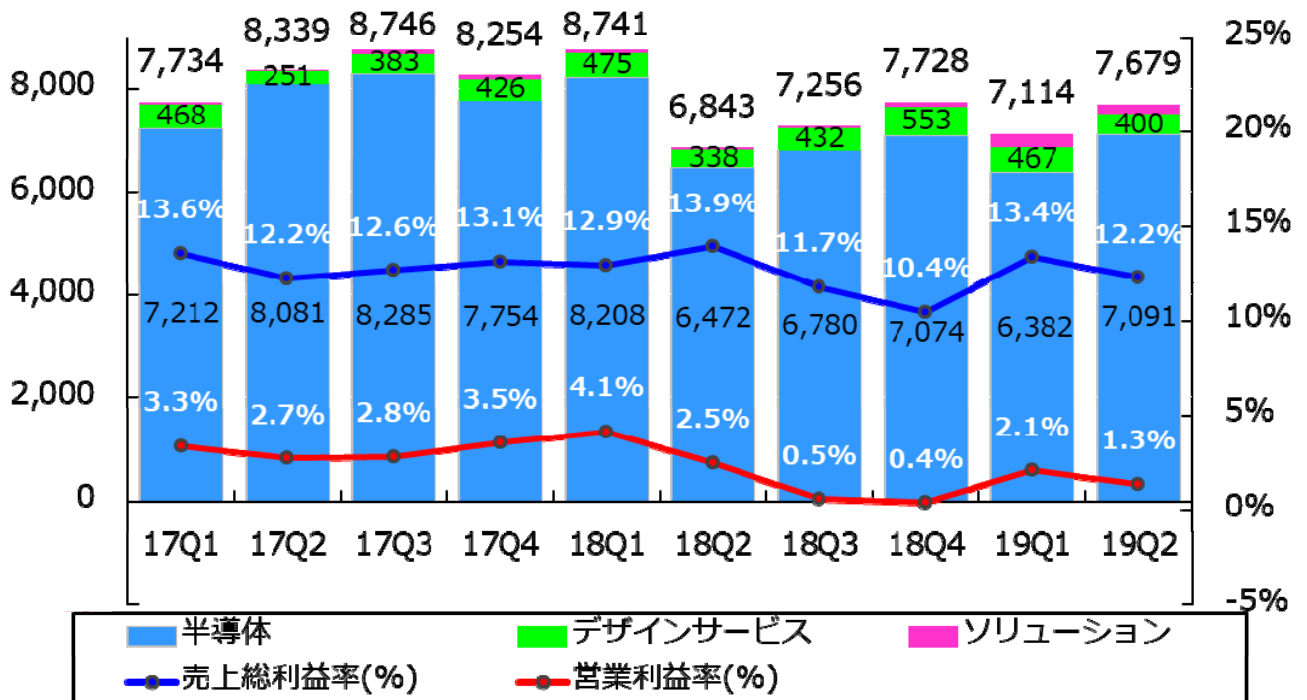
連結業績の四半期推移

(百万円)



連結業績の四半期推移 (為替の影響を除いた場合)

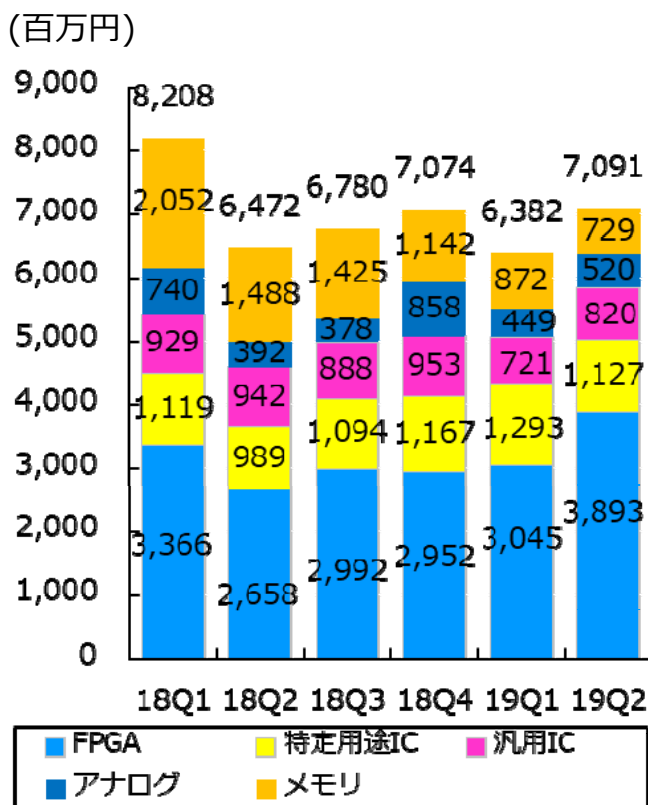
(百万円)



事業別の実績

© 2019 PALTEK Corporation. All rights reserved.

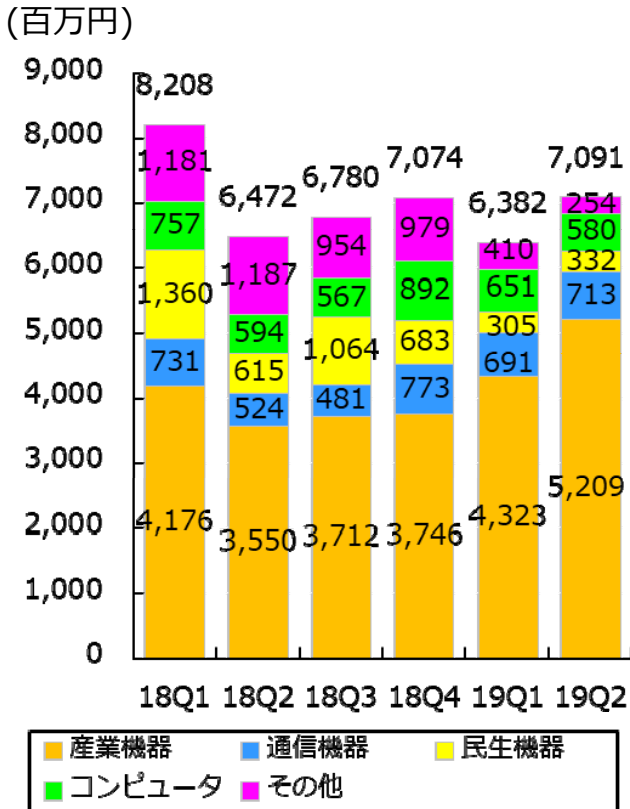
半導体事業の状況（製品別）



業績の推移

- FPGA
医療機器、計測機器向けなどが増加
- 特定用途IC
PC向けタッチパッド製品は堅調に推移するも、ブロードバンド通信向けが減少
- 汎用IC
Q1に落ち込んでいたファクトリーオートメーション向けが若干増加
- アナログ
オフィス機器向けなどが増加
- メモリ
メモリ価格下落の影響により減少

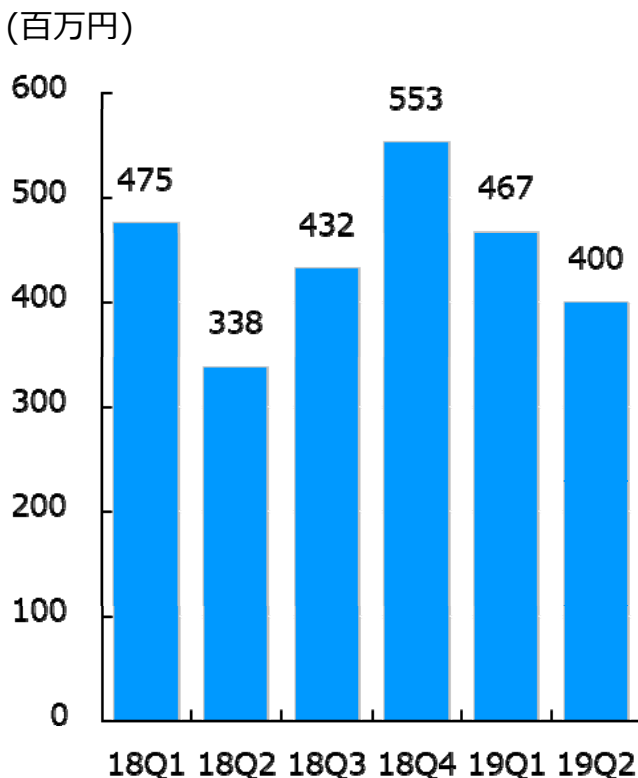
半導体事業の状況 (用途別)



業績の推移

- 産業機器
医療機器、計測機器向けなどが増加
- 通信機器
通信インフラ向けが増加
- 民生機器
携帯情報端末向けが引き続き低調
- コンピュータ
メモリ価格下落の影響によりメモリ製品が減少

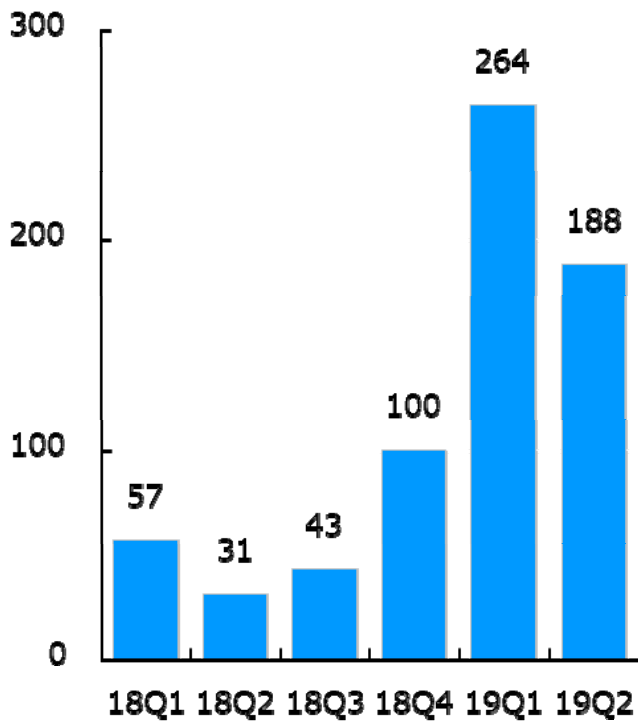
デザインサービス事業の状況



業績の推移

- 医療機器向けが増加するも、産業機器、放送機器および航空/宇宙向けなどが減少
- デザインサービス事業においては、お客様（3月決算会社）の予算との連動性が高いため、第2四半期の売上高は第1四半期に比べ、減少する傾向

(百万円)



業績の推移

- 産業向けIoTシステムは堅調に推移
- 映像配信システムが航空/宇宙分野向けに減少
- 乳幼児向け呼吸見守りシステムが減少

2

2019年12月期 業績予想

第2四半期（累計）では業績予想を上回って推移したが、下期は先行きが不透明なため、通期業績予想を変更

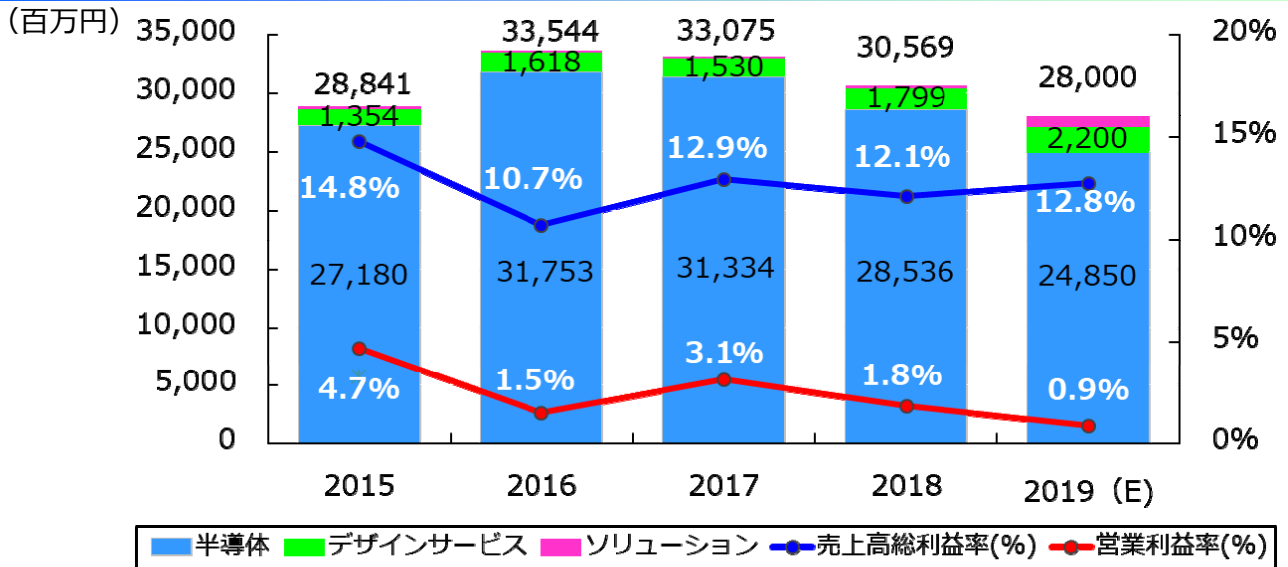
■ 第2四半期（累計）業績結果

- ・ 売上高は業績予想を上回って推移
- ・ 営業利益は、為替変動によるマイナスの影響があったものの、売上高の増加、経費の減少のため、業績予想を上回って推移

■ 通期の見通し

- ・ 米中貿易摩擦などの影響により先行きの不透明感は未だ払拭しきれない状況
- ・ 通期での売上高は変更しないが、下期の売上高は、デザインサービス事業やソリューション事業では増加するものの、半導体事業において産業機器向けなどで減少
- ・ 利益面では、デザインサービス事業やソリューション事業の売上構成比が上昇し売上総利益率は上昇するも、売上高の減少は補えず、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益ともに減少

(百万円)	2018年12月期 実績			2019年12月期 予想			通期増減	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	増減額	増減率
売上高	15,585	14,984	30,569	14,794	13,205	28,000	△2,569	△8.4%
売上総利益	1,931	1,769	3,700	1,703	1,866	3,570	△130	△3.5%
売上総利益率	12.4%	11.8%	12.1%	11.5%	14.1%	12.8%	—	—
販管費	1,549	1,592	3,142	1,641	1,678	3,320	177	5.7%
営業利益	381	176	558	61	188	250	△308	△55.2%
営業利益率	2.4%	1.2%	1.8%	0.4%	1.4%	0.9%	—	—
経常利益	227	71	299	62	137	200	△99	△33.1%
親会社株主に帰属する当期純利益	133	52	185	23	91	115	△70	△38.1%



- 売上高 : デザインサービス事業、ソリューション事業は増加するものの、半導体事業が減少
- 売上総利益率 : FPGAの利益率が低下するものの、利益率の低い半導体製品の売上高が減少すること、利益率の高いデザインサービス事業・ソリューション事業の売上高が増加するため上昇
- 営業利益率 : モデルベース開発、AIソリューションなどの新規事業への人材投資を継続するため、販売費及び一般管理費が増加し、営業利益率は低下

3

今後に向けた取り組み



PALTEKの方向性

■ 経営方針

- ・ ソリューションサプライヤーとして社会的意義ある価値を創出し、ニーズとシーズを照らし合わせた、付加価値の高い製品提案、ソリューションの開発
- ・ 収益性の高い経営を目指す

■ 各事業の方向性

ソリューション事業

基軸事業を活用し、市場ニーズに合ったソリューションを提供する事業

デザインサービス事業

半導体事業で積み重ねた強味を活かし、常に新しい技術を活用した開発力と設計品質の向上に努め、付加価値を高める事業

半導体事業

成長市場に注力し、安定的に収益を上げていく基盤事業

23

© 2019 PALTEK Corporation. All rights reserved.



PALTEKグループの強み



半導体をベースにした営業力・提案力・開発力



無線通信技術



画像処理技術



制御技術



センサ技術

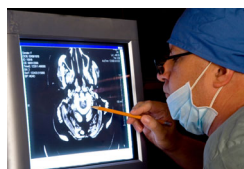


注力技術

AI、IoT、5G、ADAS、ビッグデータ、ロボット



産業機器



医療



放送・映像



公共インフラ

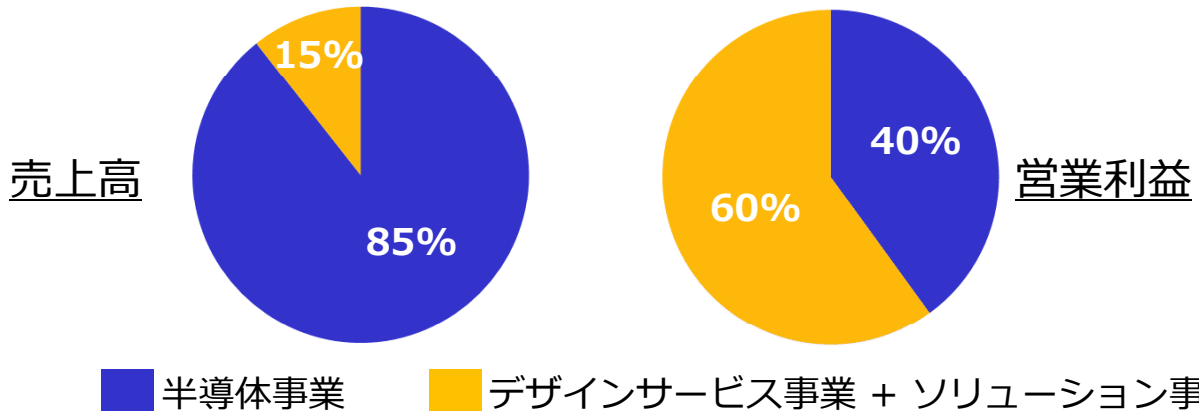


車載

■ 数値目標（2022年度）

売上高	400億円以上
営業利益率	5%以上

2022年時の売上高/営業利益の構成イメージ



基軸事業	半導体事業	<ul style="list-style-type: none"> 産業分野、通信分野などを中心に半導体関連製品を提供 AI活用分野や、IoT、データセンター、車載周辺市場などへの提案力を強化
	デザインサービス事業	<ul style="list-style-type: none"> 培ってきた技術力、設計力をベースに設計受託、ODMを行い、収益性を高める
新規事業 (投資フェーズ)	デザインサービス事業 (モデルベース開発による設計受託)	<ul style="list-style-type: none"> モデルベース開発により車載分野での設計受託案件を拡大し、成長分野で収益性を高める
	ソリューション事業	<ul style="list-style-type: none"> 基軸事業を活用し、社会的ニーズに合ったソリューションを提供し、収益性を高める

【半導体事業【基軸】】 重点施策について

【事業環境】

- **AI、ビッグデータ、IoTの活用により半導体市場が拡大**
 - さまざまなモノがインターネットに接続され、IoT関連やデータセンター向けの半導体市場が成長
- **車載分野およびその周辺市場は堅調**
 - 自動運転、電気自動車(EV)が更に発展

取り組み

- **AIを活用した提案力の強化**
- **IoT、データセンター、車載周辺市場などの成長分野に提案力を強化**
(Xilinx、Micron、Microchip、NXP、MPS)

【半導体事業【基軸】】 FPGAビジネスについて

【FPGA市場動向】

- **2017年～2023年まで年平均成長率7.8%で市場が拡大**
 - 特に車載、防衛、データセンター&コンピューティング向けでは8%以上で成長
- **ザイリンクス社では、成長市場に合わせ製品を随時投入**
 - データセンター向けにAlveo™ アクセラレータ カードを発表(2018/10)
 - 防衛グレード16nm UltraScale+™ポートフォリオ提供(2018/11)
 - Zynq UltraScale+ RFSoc ポートフォリオを拡張 (2019/2)
5G、ケーブル アクセス、レーダー アプリケーションに対応
 - AI搭載のACAP VERSAL™ AIコアシリーズなどを出荷開始(2019/6)

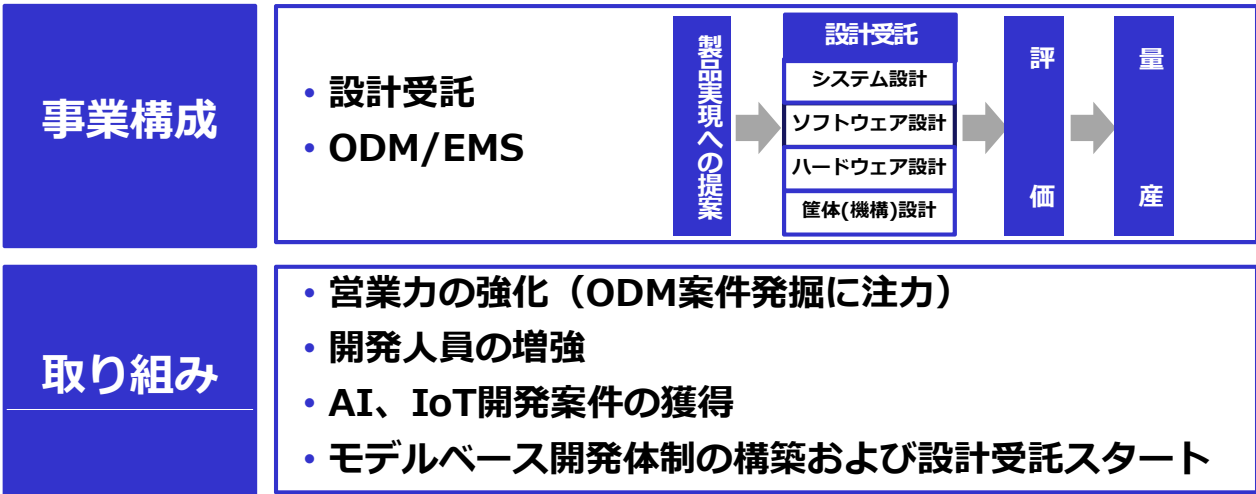
取り組み

- **5Gやデータセンター、AI活用分野に向けた提案力の強化**
- **中堅・中小企業への注力**

【デザインサービス事業【基軸】】 重点施策について

【事業環境】

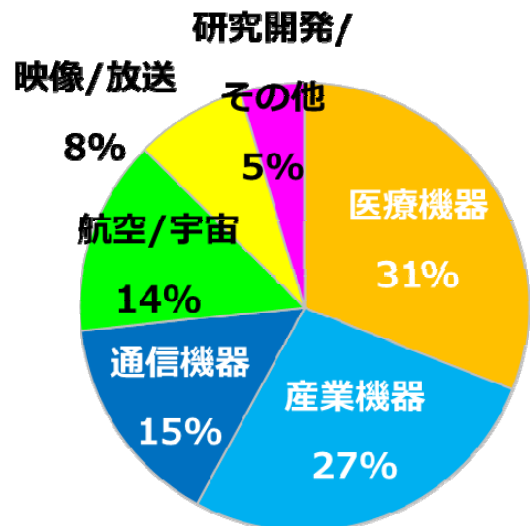
- ・ 機器自体やそれを構成する半導体などが高機能化・高度化し、すべてをお客様のみで開発することが困難
- ・ お客様は社外リソースも活用し、製品リリースの早期化が必要



【デザインサービス事業【基軸】】 設計受託およびODMの状況

- 引き続き産業機器、医療機器、通信機器での設計受託・ODMが上位を占める
- 2019年Q2(累計)では医療機器、産業機器、航空/宇宙分野向けが増加
- ODM比率は約6割で堅調に推移

用途別売上構成（2019年Q2）



【デザインサービス事業 [新規]】 モデルベース開発の取り組み

■ モデルベース開発の設計受託準備

■ ハードウェアエミュレータ「白虎」を開発

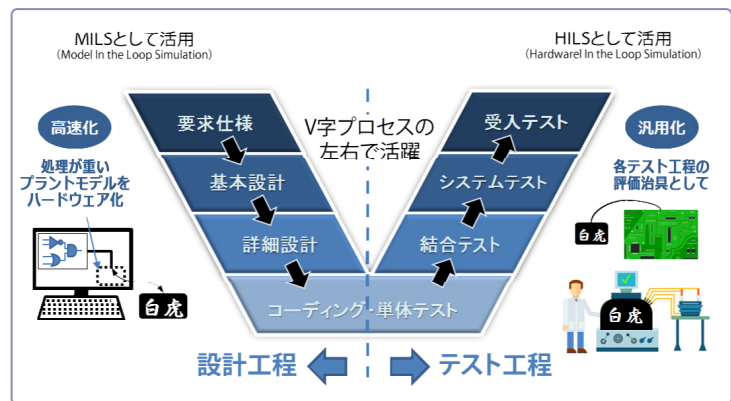
- 手軽に導入できるHILS (Hardware-in-the-loop simulation)
- 車両運動モデル、バッテリーモデルを用意
- MILS (Model-in-the-loop simulation) に活用
- モデルのハードウェア化受託



「白虎」の概要

■ 今後の取り組み

- 2019年度
 - 技術者の育成 / 人員確保
- 2020年度
 - 本格的に設計受託



【ソリューション事業 [新規]】 事業領域の開拓

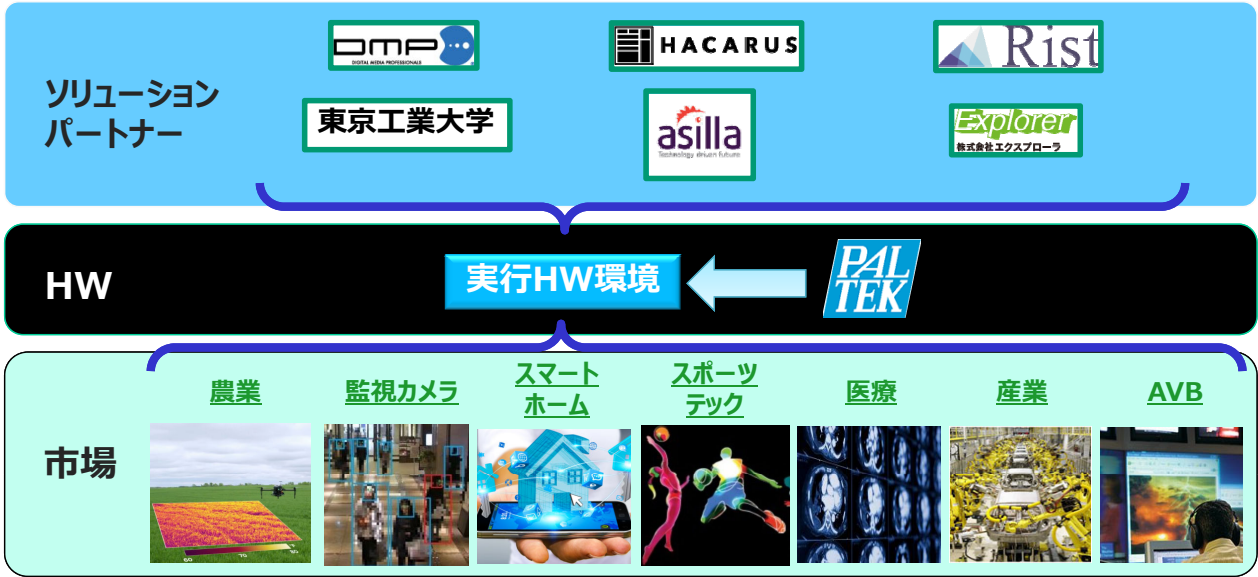
■ ソリューション事業の狙い

- 市場拡大が見込まれる分野に注力したソリューションを発掘・開発
- 将来的にIoTやサービス等の付加価値の可能性のあるソリューションを展開

	産業	映像・放送	医療・介護 ヘルスケア	自動車	物流
既存顧客	工場向け監視システム	映像配信システム	ウェアラブルロボット		梱包用紙緩衝材システム
新規顧客			乳幼児呼吸見守りシステム	TPMS 運行管理システム	ウェアラブルロボット

要素技術は、AI、通信、画像処理、センシング

【ソリューション事業 [新規]】 AIソリューションの構築

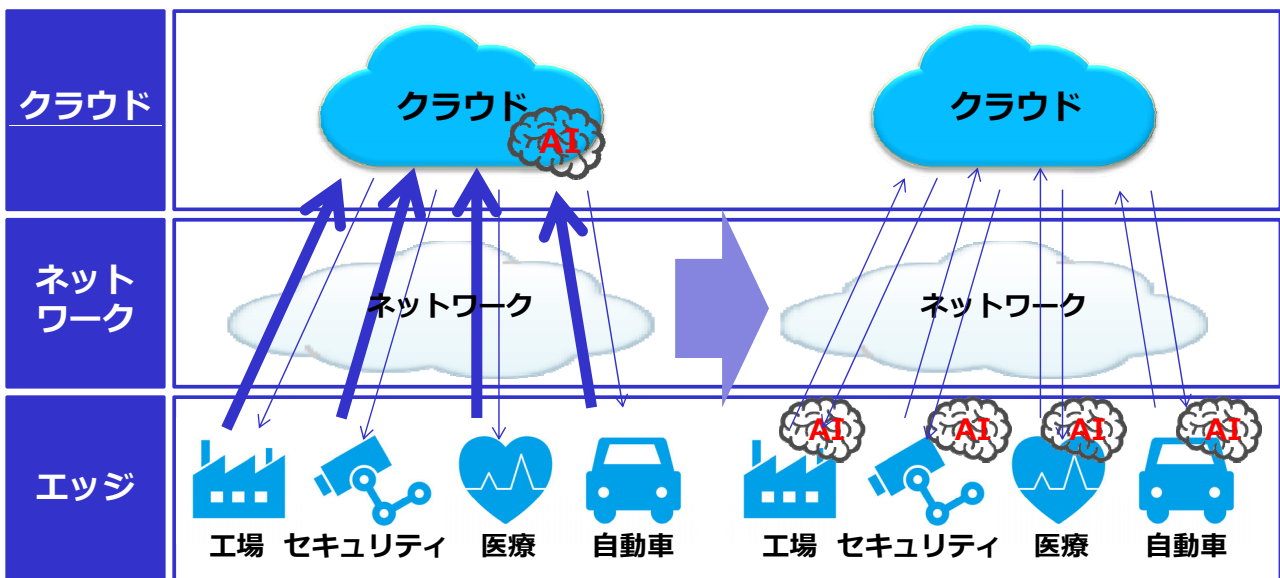


【提供ソリューション】

- 安全確保
- データの創造から生産性向上
- 未来の予測
- 人の不均一作業の均一化
- 人作業の自動化
- まだ無い市場の創造

【ソリューション事業 [新規]】 AIの在り方はエッジAIが主流に

- エッジ側(端末)にAIを搭載し、
通信料削減、遅延時間短縮、セキュリティ向上



【ソリューション事業 [新規]】 映像配信システムのビジネス進捗①

■ ビジネスの位置づけ

- 映像による情報提供ニーズが高まる中、保有する映像処理に関する技術をベースに、映像配信システムを提供
- 自社製品販売だけでなく、OEM供給や他社製品の提供も行う

■ 国内外の展示会に出展し、プロモーション実施

- 世界最大の放送機器展「NAB Show」(米国ラスベガス)に出展
 - SRTプロトコル搭載 H.265/HEVC 4K/2Kコーデックシステムを展示
 - 海外販売パートナーの開拓、連携強化



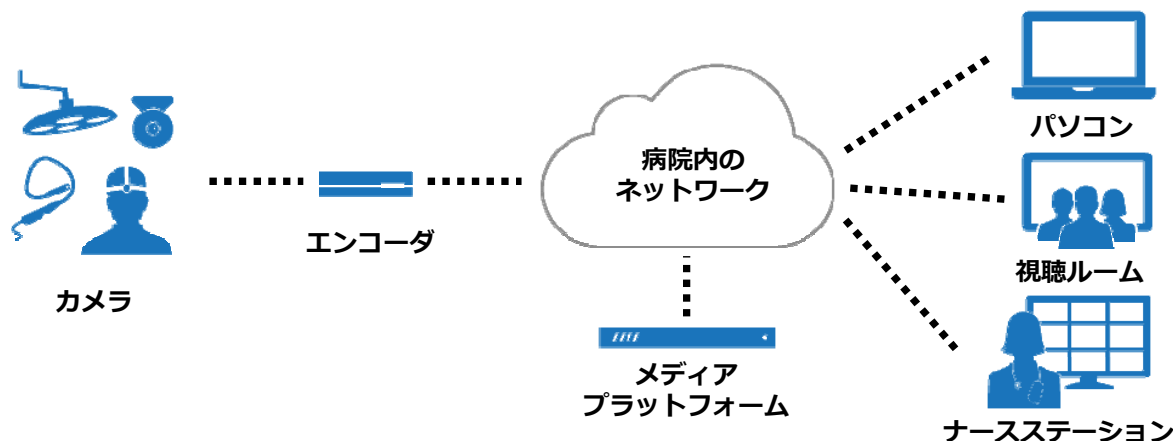
- 「第2回4K・8K映像技術展」に出展
 - コーデックシステムのほか 8K映像機器開発プラットフォームなども展示



【ソリューション事業 [新規]】 映像配信システムのビジネス進捗②

■ 航空/宇宙分野向け 映像配信システムの受注

■ 医療機関向けに 映像配信システムを提案



【ソリューション事業【新規】】 梱包用紙緩衝材システムのビジネス進捗

■ ビジネスの位置づけ



- ・ 成長すると見込まれる物流分野への事業展開
- ・ 生態系への影響懸念により脱プラスチックが進む中、プラスチック系緩衝材に代わる紙緩衝材活用による物流コスト低減提案
- ・ ストック型ビジネス

■ 「第7回通販ソリューション展 春」に出展

- ・ 開催日時：2019年5月8日～10日
- ・ 大量梱包ライン向けすき間埋め自動梱包システム「AccuFill®」などを実演
- ・ 各物流ニーズにあわせた梱包システムを展示



■ ビジネスの進捗状況（2019年6月末）

- ・ トライアル : 83社 (2019年3月末から16社増)
 116台 (2019年3月末から22台増)
- ・ 採用（累計） : 43社 (2019年3月末から9社増)
 168台 (2019年3月末から9台増)

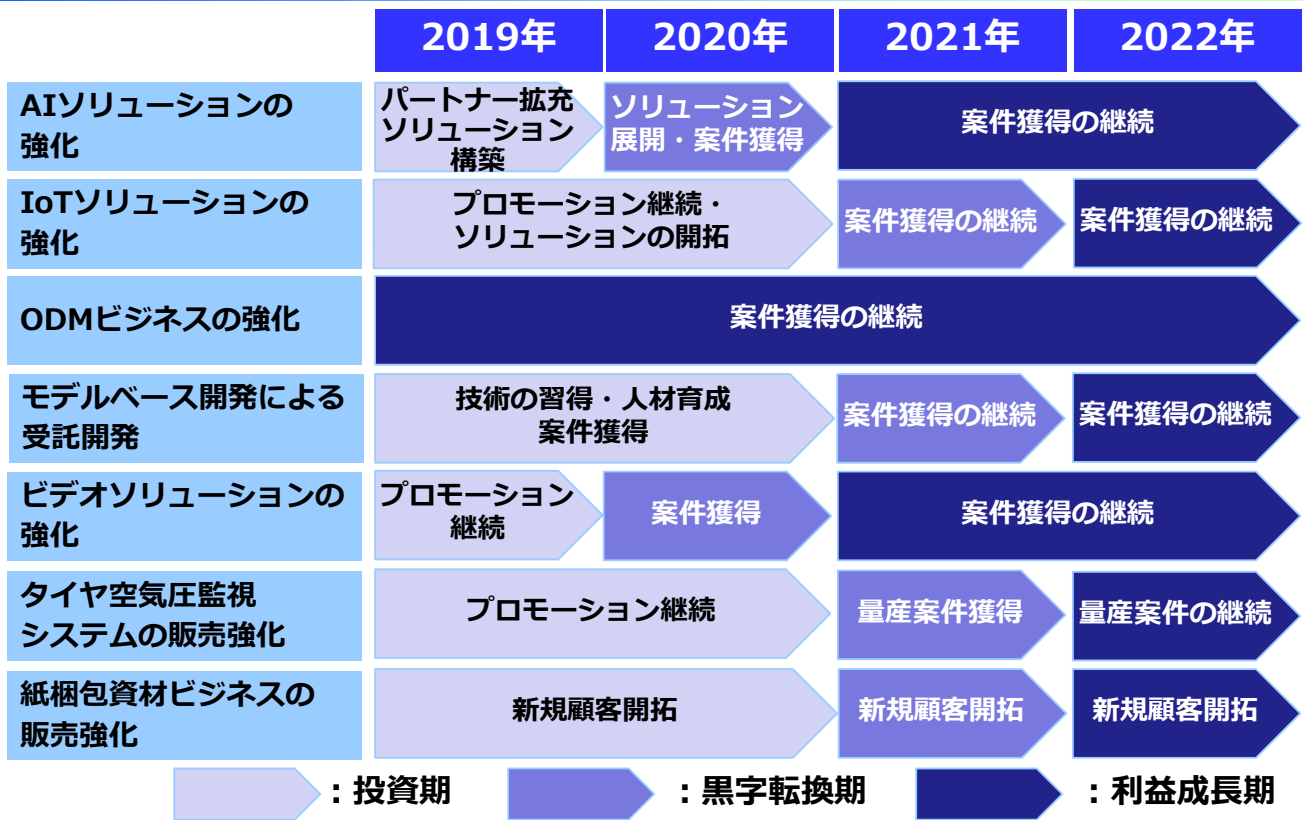
【ソリューション事業【新規】】 梱包用紙緩衝材システムの採用事例

■ 日本全薬工業株式会社

導入の背景	紙緩衝材の活用により、脱プラスチックを促進できるため	
導入の効果	出荷作業時間の大幅短縮、資材コストの削減を実現 ・ 作業時間で199万円/年 ・ 資材コストで469万円/年	

■ アイ・オー・データ機器株式会社

導入の背景	新物流拠点での梱包作業をさらに効率化するため	
導入の効果	1製品あたりの梱包時間を5～10秒短縮することができ、出荷作業時間が大幅に削減	



参 考 資 料

為替変動に関する影響

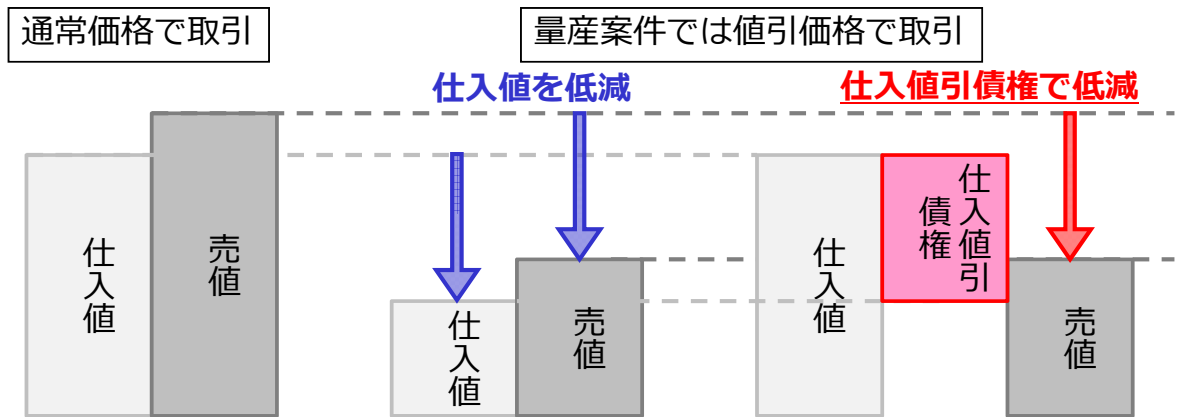
為替変動による影響について

- 為替変動により当社グループの利益は以下の4点で影響を受ける
 - ① 仕入値引ドル建債権の為替変動による影響
 - ② 調達在庫の為替変動による影響
 - ③ 決済時のドル調達レート変動による影響
 - ④ ドル建売掛金入金時のレート変動による影響

為替変動による影響の発生要因①

【仕入値引ドル建債権の為替変動による影響】

- 当社が仕入先に対して保有する『仕入値引ドル建債権』が、為替レートの変動により評価額が増減することで、業績に大きな影響を与える
- 仕入値引ドル建債権について：
 - ・ 量産案件によっては、通常価格よりも低い価格での販売を要請されることがある
 - ・ その場合、仕入先との間で仕入価格の低減交渉を行う
 - ・ その実現方法は、「仕入値自体の低減」と「仕入値引債権の付与による低減」



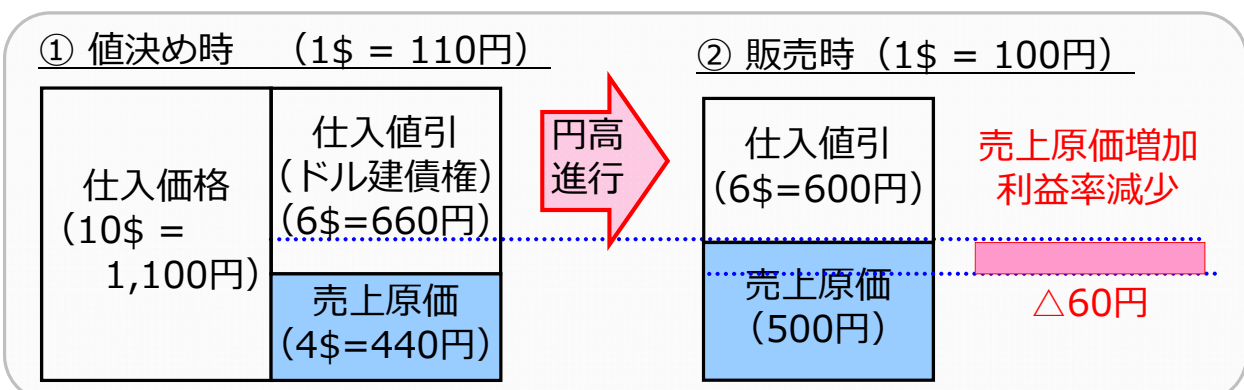
43

© 2019 PALTEK Corporation. All rights reserved.

急速な円高進行による仕入値引債権の評価額減少

- 仕入値引債権の評価額の増減は、値決め時と販売時の為替レートの差により生じる
- そのため、急速に円高が進行すると、為替レートの差が大きくなるため、仕入値引債権の評価額が大幅に減少
- これにより、売上原価が増加し、売上総利益が減少

例：仕入れ価格10ドルの製品を販売する際の売上原価の変化



44

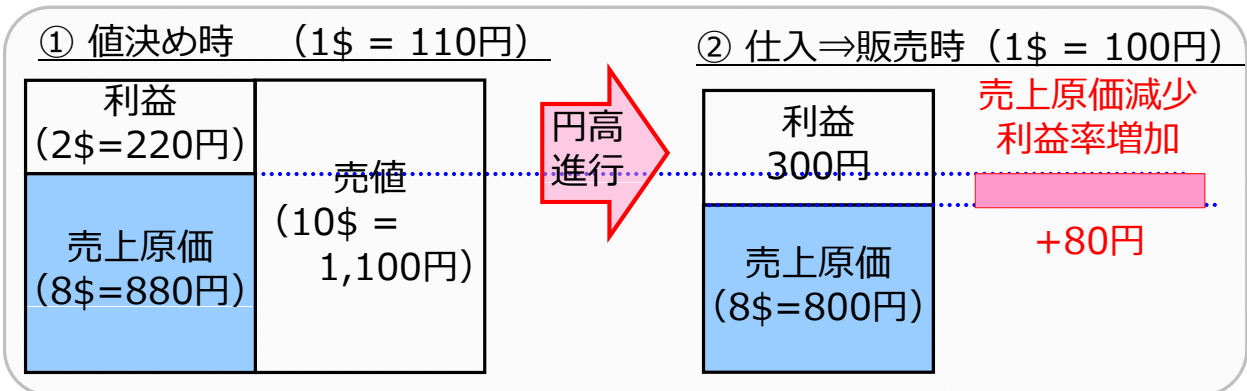
© 2019 PALTEK Corporation. All rights reserved.

為替変動による影響の発生要因②

【調達在庫の為替変動による影響】

- 海外から仕入れたドル建の製品において、為替レートが円高に進行することにより、売上原価が減少し、売上総利益は増加

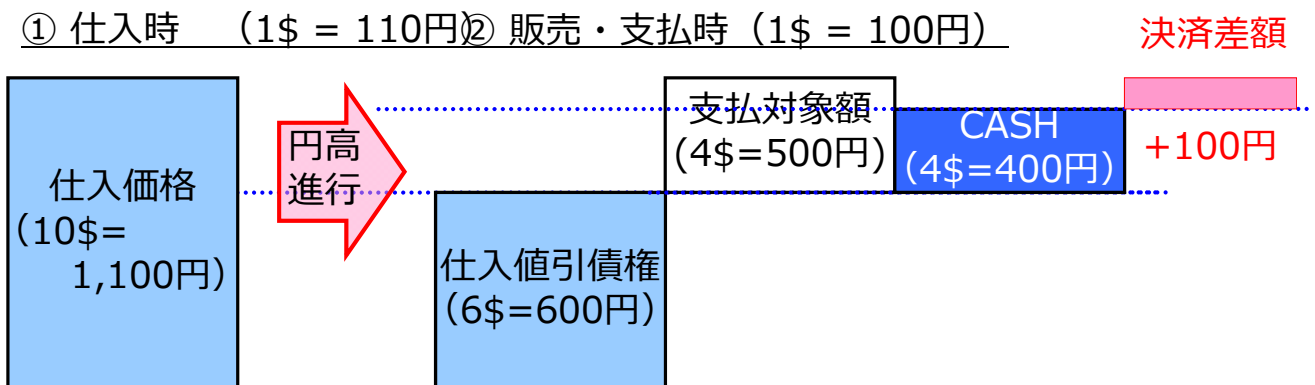
例：仕入れ価格10ドルの製品を販売する際の売上原価の変化



為替変動による影響の発生要因③

【決済時のドル調達レート変動による影響】

- 支払を行う際に円高に進行していた場合、ドルを調達する金額が少なくなるため、決済差額が生まれ、為替差益を計上することとなる
- 一方、円安に進行した場合は、為替差損を計上することとなる



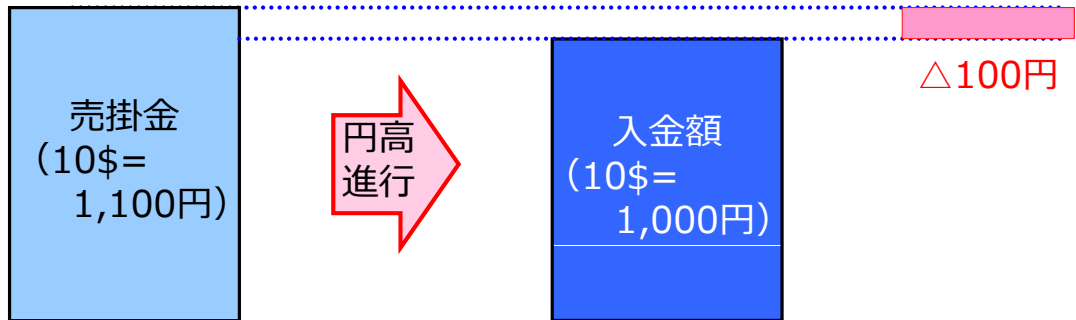
【ドル建売掛金入金時のレート変動による影響】

- ドル建売掛金のお入金がある場合には、円高に進行するとマイナス、円安に進行するとプラスの影響が発生する（営業外の為替差損益）
- 当社はこのリスクを限定的にするために、為替予約を行っている

① 販売時 (1\$ = 110円)

② 入金時 (1\$ = 100円)

決済差額



■ 売上総利益への影響額

- Q4の評価レートからQ2における評価レートから円高に進行したことにより、為替変動の影響額はマイナス方向に

(単位：百万円)	18Q1	18Q2	18Q3	18Q4	19Q1	19Q2
為替レートの変動 (円)	113→ 106	106→ (111)→ 109	111→ 113	113→ 110	108→ 110	110→ (112)→ 107
為替変動の影響 (売上総利益)	-148	3	52	59	-63	-124
仕入値引債権の評価額変動の影響	-338	-8	307	341	-396	60
調達在庫の為替レート変動の影響	189	11	-256	-280	333	-183

■ 営業外損益への影響額 (期末評価替の影響は含まず)

- 買掛金支払時のレート変動の影響は、円高進行のためプラスに (売上総利益への影響額と相殺関係に)

(単位：百万円)	18Q1	18Q2	18Q3	18Q4	19Q1	19Q2
買掛金支払時のレート変動の影響 (営業外)	88	-19	-89	-34	-15	122

- 売掛金受取時のレート変動の影響額は、Q4から円高方向に進行したことによりマイナス方向に

(単位：百万円)	18Q1	18Q2	18Q3	18Q4	19Q1	19Q2
売掛金受取時のレート変動の影響 (営業外)	-74	-25	-8	20	-42	-49

(百万円)	2018年12月期 実績			2019年12月期 業績予想			通期増減	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	増減額	増減率
半導体	14,681	13,855	28,536	13,473	11,376	24,850	△3,686	△12.9%
FPGA	6,025	5,944	11,969	6,938	5,061	12,000	30	0.3%
特定用途IC	2,109	2,262	4,372	2,421	1,878	4,300	△72	△1.7%
汎用IC	1,871	1,842	3,713	1,542	1,708	3,250	△463	△12.5%
アナログ	1,133	1,237	2,371	969	1,130	2,100	△271	△11.4%
メモリ	3,541	2,568	6,110	1,601	1,598	3,200	△2,910	△47.6%
デザインサービス	814	985	1,799	867	1,332	2,200	400	22.2%
ソリューション	89	144	233	453	496	950	716	306.9%
売上高合計	15,585	14,984	30,569	14,794	13,205	28,000	△2,569	△8.4%
営業利益	381	176	558	61	188	250	△308	△55.2%

開示区分	内容説明
半導体事業	半導体及び関連製品の販売、技術支援
FPGA	ザイリンクス社のFPGAを中心とするソリューション
特定用途IC	特定用途に特化した半導体を中心とするソリューション (例：通信向け、インタフェース向け、携帯端末向け等)
汎用IC	NXPセミコンダクターズ社、マイクロチップテクノロジー社等の汎用ICを中心とするソリューション
アナログ	アナログ半導体を中心とするソリューション
メモリ	マイクロンテクノロジー社等のメモリを中心とするソリューション
デザインサービス事業	受託開発、ODM/EMS/OEM
ソリューション事業	最終製品レベルでのソリューション提案を実施 自社製品（ハードウェア、ソフトウェア、システム）の 開発・販売



以下の担当までお問い合わせ下さい。

株式会社PALTEK

柴崎 由記 (IR担当)

〒222-0033

横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエアビル

TEL : 045-477-2072

FAX : 045-477-2012

E-mail : ir@paltek.co.jp